PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

63-105977

(43)Date of publication of application: 11.05.1988

(51)Int.Cl.

C23C 26/00 // B01D 13/04 C03C 17/06 CO3C 17/32 CO4B 41/88

(21)Application number: 61-249543

(71)Applicant : ISE KAGAKU KOGYO KK

(22)Date of filing:

22.10.1986

(72)Inventor: UTSUGI TAKESHI

HIRAKAWA SHOICHIRO

YOSHII MINORU

(54) METHOD FOR FORMING THIN FILM

(57' 'bstract:

1

PULLPOSE: To permit formation of a thin film which is thin and is hardly breakable by packing a packing material into the apertures of many small holes opened on the surface of a substrate and depositing the thin film on the substrate surface, then removing the packing material.

CONSTITUTION: A porous body having the many small holes opened on the surface; for example, porous glass, sintered body of fine ceramic grains such as Al2O3 and sintered body of fine metallic grains are used. Such porous body is formed to a prescribed shape and the packing material for example, paraffin, low melting point alloy, starch or the like is packed into the apertures of the small holes to close the small holes. The thin film is formed in this state on the surface of the porous body by a chemical plating method, vapor phase method, sputtering method, etc., then the packing material is removed by melting and evaporating by heating, physical and chemical dissolution, etc. The thin film is thereby formed to cover the apertures of the small holes and the apertures function as the supporting frame for the thin film.

⑩ 日本国特許庁(JP)

①特許出額公開

⑩公開特許公報(A)

昭63-105977

@Int_Cl.1	識別記号	庁内整理番号		砂公開	昭和63年(198	8)5月11日
C 23 C 26/0)	K-7141-4K					
// B 01 D 13/0	4	L-7141-4K R-8314-4D					
C 03 C 17/0	5	8017-4G					
17/3 C 04 B 41/8	2 3	Z - 8017-4G J - 7412-4G	審査請求	未請求	発明の数	1	(全4頁)

❷発明の名称 薄膜を形成させる方法

②符 願 昭61-249543

砂出 願 昭61(1986)10月22日

宇都木 縠 神奈川県横須賀市湘南鷹取1-24-14 砂発 明 者 千葉県山武郡大網白里町大網511-6 平川 正一郎 の発明 者 の発明 者 吉 井 奥 千葉県茂原市木崎743 東京都中央区八重洲2丁目7番12号 ⑪出 願 人 伊勢化学工業株式会社

四代 理 人 弁理士 科村 繁郎 外1名

明 相 曾

1. 発明の名称

1

薄膜を形成させる方法

2. 特許請求の範囲

(1) 表面に関孔する多数の小孔を有する基体の は小孔関孔部に充填材を充填し、次いで基体表面 に確認を被着せしめた後充填材を除去することを 特徴とする多孔質体表面開孔部を関って確認を形 或させる方法。

(2) 多孔質体は多孔質硝子であることを特徴と する特許請求の範囲第1項記載の存譲を形成させ る力法。

(3) 小孔の大きさは40~100,000 人であること を特徴とする特許額求の範囲第1項又は第2項記 載の稼騰を形成させる方法。

3. 発明の詳細な説明

[発明の目的]

(産業上の利用分野)

太亮明は多孔質体表面跳孔部を覆って部腺を形

成させる方法に関するものである。

(従来の技術)

Pd域、Ni酸、シリコーンゴム駅、ポリイミド駅等の移駅は水紫分離、酸紫宮化等の各種用途に使用される。従来法にあっては、干め所定厚みの移 膜を製造し、この砂膜を支持や等で支持して使用する。移設には、このような枠体への取付方法。 支持方法に耐えるだけの機械的強度を附与する必要があり、あまり符い機を使用すると枠体への取付工程或は使用中に破損し易い。又移設の外には製造工程上の制約もあり、あまり厚みの小さいものは実用化されていない。

移版を支持やで支持して使用する場合、支持や 関孔部のディメンションが小さい程、厚みの小文 い酸を使用することが可能となる等である。こと 持枠開孔部を覆って直接確既を形成させることが できれば、健既を神体に取付ける扱の破損も生ず ることがなく、様い既を使用することが可能とな る理である。しかし乍ら、このような技術的命題 を解決する方法は知られておらず、膜厚が大きく

特開昭63-105977(2)

なると性能が低下する場合でも、止むを得ず、厚 い腹を使用せざるを得なかった。

(発明が解決しようとする問題点)

本発明は従来技術が有していた前述の問題点を解決し、従来知られていなかった枠体の開孔部を取って直接体験を形成する方法を新規に提供することを目的とするものである。

【発明の構成】

(問題点を解決するための手段)

本発明は前述の問題点を解決すべくなされたものであり、表面に関孔する多数の小孔を有する基体の駄小孔明孔部に充樹材を充塡し、次いで基体表面に薄膜を被着せしめた技充塡材を除去することを特徴とする多孔質体表面開孔部を覆って薄膜を形成させる方法を提供するものである。

本発明においては、裏面に開孔する多数の小孔を有する多孔質体を使用する。このような多孔質体を使用する。このような多孔質体としては A2 *0, 等のセラミックス 敬拉の焼結体、金属敬社の焼結体、多孔質硝子が例示されるが、多孔質硝子を使用するのが好ましい。

このようにして生成した CaO 、 BaO。 を主成分と する分相を溶解除虫することによって多孔質硝子 が形成される。

8±0。は上述の説明からも首負しうるように小孔の大きさを決定する重要な因子であり、分相中に移行して除去される 8±0。 量、成は逆に多孔研子中に残存する 8±0。 量は、小孔の揺の均一性と街浪な関係を有することが判明した。

上記成分を前述の範囲内に保つことにより 針道 な多孔質体をうることができる。

研子A、Bを所定形状に成型した後熱処理して C=0、 B=0 を主体とする相(以下 Ca0 、 B=0 和という)を分相せしめる。加熱処理温度がある。 Q 独立 理 理 関 が 長い程 Ca0 、 B=0 和 相 は 大 な り、 従って のられる 多 孔 硝子 の で 表 の は り に し な で を る。 このように し て 不 免 明 の 任 は り 一 で あ り 、 本 発 明 の で あ ら に し か で あ の に 極 め て 好 適 な も の で あ る。

多孔質研子としてはバイコール 例子、或は $Si0_v$ $45\sim70$ vt%、 B_z0_s $8\sim30$ vt%. Ca0 $8\sim25$ vt%, $A2_z0_s$ $5\sim15$ vt%. Pa_z0 $3\sim8%$, Pa_z0 $1\sim5%$. Pa_z0 $4\sim13$ vt%, Pa_z0 $1\sim5%$. Pa_z0 $1\sim5%$.

上述した組成を有する硝子A又はBの上配成分のうち S10。は分相、換去工程によって得られる多孔硝子の骨格を形成するための基幹成分であり、 A2 a0。は補助成分として得られた多孔硝子の散さを減少させる作用を有する。 Ba0。は一方において多孔硝子の骨格を形成する補助成分として改能するが、他方Ce0 と協同して、熱処理によって数少な分相を生成する作用を有する。そして

加熱処理を行った硝子をHC 2、 Ha SO 。、 HMO a 等の酸中に侵債して CaO 、 Ba Oa 相を溶解除去す る。なお酸処理を行なうに先立ち、HF 溶液で短時 間その変面をエッチング処理するのが望ましい。

前述したように熱処理の条件によって、 得られる多孔前子の小孔の径を制御することができるが、 小孔の径は多孔質硝子中に残存する B_{*}O_{*}の 最に応じて変化すること及びこの B_{*}O_{*}の 最は熱処理、酸処理の条件によって左右されることが判明した。そして B_{*}O_{*} が選ましく0.5 mt%以上残存するようこれらの条件を定めることにより特に舒適な結果の得られることが判明した。

望ましい処理条件は次の通りである。

加熱温度 600 ~850 ℃

加熱時間 2~48hr、望ましくは12~24hr

盤の種類 HCL、HaSO4、 HNOs

触の論成 0.01~2.0 N、組ましくは0.1 ~ 1.0 N

処理時間 2~20hr、望ましくは4~16hr 温 度 50~95℃、望ましくは80~90℃ 本発明においては、所定形状に形成した多孔貝体を基体として使用する。このような基体は例えば所定形状に成型した原料硝子に分相処理、溶解処理を施こすことによって得ることができる。

充填材としてはバラフィン、低融点合金、CMC(カルボキシメチルセルローズ)、観動等を用いることができる。これらの充填材は溶融或は溶解して液状として使用し、小孔中に充填した後、冷却或は溶解の蒸発等の手段により望ましく

のであれば足り、必ずしも固体である必要はなく、 定動バラフィン、寒天、水銀、比較的粘稠な 数数御等を用いることも可能である。

又成る種の液体も充填材として機能することが 判明した。例えば [Pd(NHa)4]Claを用いて化学 メッキ法によってPd膜を形成させる際、低級アル コールが有効に機能することが判明した。

その作用については明らかではないが、 $[Pd(NH_2)_4]CQ_2$ は低級アルコールに溶解性を有しないため、低級アルコールを変換した基体に $[Pd(NH_2)_4]CQ_2$ 泊液を接触せしめると、昇倒において $[Pd(NH_3)_4]CQ_2$ が折出することも一因と考えられる。

御膜を形成させた後、充限材を除去する。除去手段に特に限定はなく、加熱溶熱蒸発、物理的又は化学的溶解或は化学分解等の手段を例示することができる。例えばパラフィン、低融点合金は加熱溶融。或は物理的又は化学的溶解によって、整数質充填材は酵素を用いて分解することにより除去することができる。

は囚化せしめる。

小孔に充塡する手段に特に限定はないが、基体の一方の側を課圧状態として、上記のような充塡材を含む液体を基体の也方の側に換触させて吸引する方法、或は基体を容器中に収納し、容器を真空源と複続して基体の小孔中に含まれる空気を充分脱気し、次いで容器中に充塡材を含む液体を注入する等の方法を用いることができる。

小孔を閉窓した基体上に存践を形成させる。この森基体の関孔部以外の表面部分に附着している 充塡材は、予め充分除去するのが適当である。

移政の種類及び形成方法には特に限定はなく、 形成方法としては化学メッキ法、気相法、スパッタリング法、真空高着法、強和法等の公知の公知の、文明としては金属膜、セラミックス膜、プラスチック酸、ゴム膜、シリコーン膜等を形成示することができる。なお充塡材は、作品を形成するのを防止し、数材料を文持する作用を有するも

太兔明存践は各種用途に使用することができ ×

例えば多孔質硝子を基体として用いてPd膜を形成させ、水素分離用媒体として用いることができる。又 A 2 g 0 g 粒焼結体を基体として用い、極めて散少な小孔を有するセラミック体膜を形成させ、或は金銭膜を形成させ、フィルターとして用いることもできる。

(作用)

基体小孔関口部に充塡された充壌材が、基体表面に存限を形成させる際の支持体として機能し、 小孔関口部を覆って部膜が形成され、関口部が薄膜の支持体として機能する。

(突施例)

平均5,000 人の多数の小孔を有する、 AleQa 焼結体より なる 級状体 (厚み 1 0 mm、大きさ 1 0 cm× 1 0 cm) を基体として使用した。

この基体を容易中に収納して脱氢し、缺容器中 に投動パラフィンを住入し、基体の関ロ部を流動 パラフィンで充関した。設画に付着したパラフィ

特開昭63-105977(4)

ンを充分除去し、その一箇に銀銭反応を利用し、 厚さ2~3 μのAg膜を形成させ、次いで基体をで 充分洗涤し、充壌されたパラフィンを除去するこ とにより A2 10, 焼動体の関口部を覆って厚さ 2~3 μのAg存膜を形成させた。

(灾絶例 2.)

(

平均40人の多数の小孔を有するバイコール研 子よりなる実施例1ど同一の大きさの板状体を基 体として使用した。

実施例 1 と同様の手段により関ロ部に低触点合 会を充填し、スパッタリング法により厚み 0.5 μ Au腹を形成させた。

充塡された合金を触処理によって除去し、バイコール研子の閉口部を関って厚さ0.5 μのAu製物 腹を形成させた。

> 特許出願人 伊勢化学四次的大会社 代理人 超村繁